



<b>Title of Change:</b>	ASESH Epoxy changed from YIZBOND 8143 to CRM-1076WA for LQFP Package.					
<b>Proposed first ship date:</b>	1 August 2019					
<b>Contact information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Keiji.Ueda@onsemi.com>					
<b>Samples:</b>	Samples should be available after completion of qualification. Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.					
<b>Additional Reliability Data:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <a href="mailto:Toshiya.Matsunami@onsemi.com">Toshiya.Matsunami@onsemi.com</a>					
<b>Type of notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact < <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a> >					
<b>Change Part Identification:</b>	Product material with date code after qualification completion will be built with noted change.					
<b>Change Category:</b>	<input type="checkbox"/> Wafer Fab Change <input checked="" type="checkbox"/> Assembly Change <input type="checkbox"/> Test Change <input type="checkbox"/> Other _____					
<b>Change Sub-Category(s):</b>	<input type="checkbox"/> Manufacturing Site Addition <input checked="" type="checkbox"/> Material Change <input type="checkbox"/> Datasheet/Product Doc change <input type="checkbox"/> Manufacturing Site Transfer <input type="checkbox"/> Product specific change <input type="checkbox"/> Shipping/Packaging/Marking <input type="checkbox"/> Manufacturing Process Change <input type="checkbox"/> Other: _____					
<b>Sites Affected:</b>	ON Semiconductor Sites: None	External Foundry/Subcon Sites: ASE Shanghai				
<b>Description and Purpose:</b>						
ASESH Epoxy changed from YIZBOND 8143 to CRM-1076WA for LQFP Package. The change is due to YIZBOND-8143's supplier announce for closure.						
	<b>Before Change Description</b>	<b>After Change Description</b>				
Die Attach	YIZBOND-8143	CRM-1076WA				
There is no product marking change as a result of this change.						
<b>Reliability Data Summary:</b>						
QV Device Name: LC821621 RMS: 50891 Package: LQFP216						
<b>Test</b>	<b>Specification</b>	<b>Conditions</b>	<b>Interval</b>	<b>Lot A</b>	<b>Lot B</b>	<b>Lot C</b>
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260 °C		All	All	All
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to + 150°C	500 cyc	0/80	0/80	0/80
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80	0/80	0/80
<b>Electrical Characteristic Summary:</b> Electrical characteristics are not impacted.						
<b>List of Affected Parts:</b>						
<b>Note:</b> Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <b>PCN Customized Portal</b> .						
<b>Part Number</b>		<b>Qualification Vehicle</b>				
LC821621-E		LC821621-E				

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22444X

発行日 : 25 April 2019

変更件名:	ASE 上海組立の LQFP パッケージにおいてダイ接着剤を YIZBOND 8143 から CRM-1076WA に変更					
初回出荷予定日:	1 August 2019					
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Keiji.Ueda@onsemi.com> にお問い合わせください。					
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。					
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <u>Toshiya.Matsunami@onsemi.com</u> にお問い合わせください。					
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。					
変更部品の識別:	認定終了後の日付コードの付いた製品材料は通知された変更で作られています。					
変更カテゴリ:	<input type="checkbox"/> ウェハファブの変更 <input checked="" type="checkbox"/> アセンブリの変更 <input type="checkbox"/> 試験の変更 <input type="checkbox"/> その他 _____					
変更サブカテゴリ:	<input type="checkbox"/> 製造拠点の追加 <input checked="" type="checkbox"/> 材料の変更 <input type="checkbox"/> データシート/製品資料の変更 <input type="checkbox"/> 製造拠点の移転 <input type="checkbox"/> 製品仕様の変更 <input type="checkbox"/> 出荷/パッケージング/表記 <input type="checkbox"/> 製造プロセスの変更 <input type="checkbox"/> その他: _____					
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: なし	外部製造工場 / 下請業者拠点: ASE Shanghai				
説明および目的:	LQFP パッケージ用に YIZBOND 8143 から CRM-1076WA に変更した ASE 上海におけるダイ接着剤変更は YIZBOND-8143 のサプライヤ閉鎖の発表に基づくものです。					
	<b>変更前の表記</b>	<b>変更後の表記</b>				
<b>ダイ接着剤</b>	YIZBOND-8143	CRM-1076WA				
今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。						
信頼性データの要約:	<b>デバイス名:</b> LC821621 <b>RMS:</b> 50891 <b>パッケージ:</b> LQFP216					
<b>テスト</b>	<b>仕様</b>	<b>条件</b>	<b>間隔</b>	<b>ロット A</b>	<b>ロット B</b>	<b>ロット C</b>
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260 °C		All	All	All
TC	JESD22-A104	Ta= - 65°C to + 150°C	500 cyc	0/80	0/80	0/80
UHASt	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80	0/80	0/80
電気的特性の要約:	電気的特性への影響はありません。					
影響を受ける部品の一覧:	注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。					
<b>部品番号</b>	<b>認定試験用ピークル</b>					
LC821621-E	LC821621-E					



---

## Appendix A: Changed Products

---

D

---

Product	Customer Part Number	Qualification Vehicle
LC821621-E		LC821621-E